

Siltronic AG

**Ansprache zur
Hauptversammlung 2018**

19. April 2018

Dr. Christoph von Plotho, CEO

“Wachstum mit Wafern”

Ansprache vor den Aktionären der Siltronic AG auf der Hauptversammlung am 19. April 2018 in München

Dr. Christoph von Plotho, CEO Siltronic AG

Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Aktionärsvertreter,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie sehr herzlich – auch im Namen meines Vorstandskollegen, Rainer Irle,
– zur heutigen Hauptversammlung.

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter der Siltronic AG. Sowohl beim Umsatz wie auch bei der EBITDA-Marge war die Entwicklung deutlich besser als zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet.

Die Impulse in der Halbleiterindustrie waren - und sind immer noch - unvermindert positiv. Die Nachfrage nach unseren Wafern ist höher als unsere Produktionskapazität. In diesem Marktumfeld konnten wir 2017 die durchschnittlichen Verkaufspreise für unsere 200 mm- und 300 mm-Wafer deutlich erhöhen.

Wir haben unsere kontinuierlichen Kostensparprogramme erfolgreich fortgesetzt und 2017 Einsparungen von rund 15 Millionen Euro erzielt.

Unsere Profitabilität ist signifikant gestiegen. 2017 betrug die EBITDA-Marge 30 Prozent im Vergleich zu 16 Prozent im Vorjahr.

Bevor ich tiefer in die Finanzkennzahlen einsteige, lassen Sie mich kurz auf unsere Aktie, das Thema Technologieführerschaft und das Marktumfeld eingehen.

Letztes Jahr habe ich über einen positiven Verlauf unseres Aktienkurses berichtet. Dieser Aufwärtstrend hat 2017 angehalten und unser Aktienkurs lag Ende Dezember im Xetra-Schlusskurs bei 121,30 Euro und damit 176 Prozent über dem Schlusskurs des Vorjahres. Damit hat er sich besser entwickelt als der TecDAX oder der Philadelphia Semiconductor Sector Index.

Auch im aktuellen Jahr zeigt unsere Aktie einen positiven Verlauf. Gestern Abend lag der Xetra-Schlusskurs bei 152,50 Euro. Damit hat sich der Kurs seit dem IPO im Juni 2015 verfünffacht.

Aufgrund der guten Kursentwicklung und der damit verbundenen höheren Marktkapitalisierung ist die Siltronic-Aktie am 18. Dezember 2017 in den Stoxx 600 Europe aufgenommen worden.

Meine Damen und Herren, wir wollen Sie als Anteilseigner der Siltronic AG an der guten Entwicklung des Unternehmens partizipieren lassen. Im September 2017 hat der Vorstand erstmalig eine Dividendenpolitik beschlossen. Diese sieht vor, dass rund 40 Prozent des auf die Siltronic-Aktionäre entfallenden Periodengewinns als Dividende ausgeschüttet werden.

Heute schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Dividendenzahlung von rund 75 Millionen Euro und einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent bezogen auf den Schlusskurs Ende Dezember 2017.

Bereits in der Hauptversammlung 2017 war die Wacker Chemie AG mit 30,8 Prozent Aktienanteil keine Mehrheitseignerin der Siltronic AG mehr. Das, was ich auf der letzten Hauptversammlung dazu gesagt habe, gilt unverändert.

Wir haben in den vergangenen Jahren große Erfolge bei der Verbesserung unserer Profitabilität erzielt. Wir haben unsere Produktivität und unsere Wettbewerbsfähigkeit signifikant erhöht. Dies hatten wir auch durch eine gute Kooperation mit einer starken Muttergesellschaft erreicht. Dafür sind wir dankbar.

Doch seit März letzten Jahres haben wir bewiesen, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um die Herausforderungen, die unser Geschäft mit sich bringt, außerhalb des Wacker-Konzerns, zu meistern.

Meine Damen und Herren, Siltronic gehört zu den weltweit führenden Waferherstellern für die Halbleiterindustrie. Ein überaus dynamischer Markt, der eine konstante Weiterentwicklung im Technologiebereich fordert. Nur wer bei der Design Rule-Entwicklung die Nase vorne hat, kann hier bestehen. Gleichbleibend hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen: Das ist es, was unsere Kunden wollen. Und deswegen ist unser Motto „stay one generation ahead“.

Sie wissen, unsere Wafer sind die Grundlage für Halbleiterchips in Smartphones und Computern, im Auto, in der Medizintechnik, in der Luftfahrt – um nur einige prominente Beispiele zu nennen. Aber natürlich auch in vielen anderen industriellen Bereichen und im privaten Lebensumfeld. Je nach Einsatz der Halbleiter werden unterschiedliche technologische Anforderungen an unsere Wafer gestellt.

Die Waferproduktion gliedert sich in zwei große Abschnitte – das Kristallziehen und das Wafering. Beide sind gleichermaßen wichtig.

Im ersten Schritt wird aus einer polykristallinen Schmelze ein leistungsfähiger Monokristall gezogen. Im zweiten Schritt wird dieser Kristall dann zu Wafern veredelt.

Um eine hohe Leistungsfähigkeit der Wafer zu garantieren, ist die exakte Kontrolle jedes einzelnen Prozessschrittes unabdingbar. Viele Spezifikationsparameter müssen dabei beachtet werden. Und wir müssen gewährleisten, dass diese Spezifikationen

hunderttausendfach pro Monat fehlerfrei reproduzierbar sind – und das für jede einzelne Anwendung.

Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Oberflächenreinheit mag simpel klingen. Doch bereits kleinste Staubpartikel, wie zurzeit bei „Dieselgate“ diskutiert, würden den Wafer unbrauchbar machen. Dieselfeinstaub wird in Mikrometern gemessen.

Oberflächenpartikel auf unseren Wafern dagegen nur in wenigen Nanometern – eintausend Mal kleiner als Feinstaub.

Der Kunde – meine Damen und Herren – spezifiziert einen Wafer mit größenordnungsmäßig 100 Parametern. Bei jeder neuen Design-Rule Entwicklung durch unsere Kunden steigen die Anforderungen für rund 50 Parameter gleichzeitig signifikant an.

Einer dieser Parameter ist zum Beispiel die Randebenheit. Stellen Sie sich den Chiemsee vor. In Analogie zur aktuellen Performance unserer Wafer bezüglich der Randgeometrie darf die Ebenheit seiner Oberfläche von rund 80 Quadratkilometern nur durch die Dicke eines Baumblattes gestört sein.

Unsere Innovationsprojekte erstrecken sich über mehrere Jahre und orientieren sich an den Projekten der technologisch führenden Kunden.

Wie ich bereits erwähnte, wollen wir eine Generation voraus sein. Damit gewährleisten wir, dass wir unsere Kunden bereits in Entwicklungsphasen mit geeigneten Wafern unterstützen können.

Der 300 Millimeter-Wafermarkt wird auch weiterhin durch die neuesten Design Rule-Prozesse getrieben. Sind diese einmal eingeführt, dominieren sie einen Großteil des Marktes, bis sie durch die nächste noch anspruchsvollere Design Rule ersetzt werden. Dieser Trend wird vor allem durch großvolumige Anwendungen im Speicherbereich und

den Logikbereich getrieben. Um hier immer vorne dabei zu sein, arbeiten wir mit vielen Kunden in gemeinsamen Entwicklungsprogrammen zusammen.

Und dabei müssen wir natürlich höchsten Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Und unsere Kunden sind anspruchsvoll – schließlich gehören dazu namhafte Halbleiterproduzenten wie Samsung, Intel oder Infineon – um nur einige wenige zu nennen.

Dass wir beim Thema Qualität vorne dabei sind – meine Damen und Herren – das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen.

Wir sind stolz, dass wir bereits das achte Mal in Folge von Intel ausgezeichnet wurden. Im März dieses Jahres haben wir wieder den PQS-Award verliehen bekommen. Dies ist nur ein Beispiel, wie hoch unsere Qualität bei führenden Halbleiterherstellern geschätzt wird.

Meine sehr geehrten Damen und Herren – lassen Sie uns einen Blick auf die Endanwendungen werfen, in denen Halbleiterbauteile und damit Wafer zu finden sind. Die Endmärkte werden immer vielfältiger und bieten somit neue Wachstumschancen.

Lange Zeit dienten Wafer hauptsächlich als Baustein für Computer-Chips. Damit war unsere Industrie von den Zyklen des PC-Marktes abhängig. Anfang der 2000er haben wir mit dem aufkommenden Boom der Smartphones einen neuen starken Endmarkt gesehen. Und heute gehen unsere Wafer in noch weit mehr Endmärkte. Dazu zählen unter anderem der Automobilbereich und unterschiedlichste Industriebereiche.

Der ein oder andere von Ihnen wird heute mit dem Auto nach München gefahren sein, ohne groß darüber nachzudenken, wo in Ihrem Pkw Halbleiterbauteile zum Einsatz kommen. Die Anwendungen sind vielfältig. Sie finden sie in Fahrerassistenzsystemen, in Sicherheitssystemen, natürlich in Ihrem Navigationssystem, aber auch bei der Motorsteuerung.

Autonomes Fahren ist das Stichwort, wenn es um die Zukunft des Automobils geht. Zwar nicht schon morgen! Aber die Entwicklungen lassen sich nicht aufhalten. Doch ohne den Grundbaustein Wafer wird autonomes Fahren nicht zu realisieren sein. Denn autonomes Fahren funktioniert nur, wenn alles miteinander vernetzt ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass hochauflösende Straßenkarten in Echtzeit heruntergeladen, Sensordaten wiederum hochgeladen und Software-Updates zur Verfügung gestellt werden müssen.

Voraussetzung hierfür ist eine Netzinfrastruktur mit hoher Datengeschwindigkeit, die die extrem hohen Datenmengen, die von autonomen Fahrzeugen generiert werden, auch verarbeiten kann. Dabei muss die Vernetzung nicht nur vom Auto in das Netz und umgekehrt, sondern auch von Auto zu Auto gewährleistet sein. Die generierten Daten müssen bestmöglich genutzt werden.

Dass die Applikationen in einem Smartphone immer vielfältiger werden – darüber muss ich wohl kaum sprechen. Heute ist ein Smartphone nicht nur mit einer Kamera, sondern mit zweien ausgestattet. Es gibt Fingerabdrucksensoren, Gesichtserkennung und vieles mehr. Aber der wichtigste Treiber für Wafer ist das Wachstum der Speicherfläche. Waren es in frühen Smartphone-Generationen noch 4 GB, sind es heute schon 256 GB. Und ich glaube nicht, dass hier schon das letzte Wort gesprochen wurde. Denn der Trend zum Beispiel nicht nur wenige Fotos, sondern ganze Medienbibliotheken, die auch Filme umfassen, immer bei sich zu haben, steigt immer weiter.

Generell ist die Zunahme der weltweiten Datenmenge ein Wachstumstreiber im Speicherbereich. Daten werden gesammelt, um gespeichert und verarbeitet zu werden. Die Datenmenge hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Circa 90 Prozent der heute existierenden Daten wurden in den letzten zwei Jahren generiert. Wir stehen wahrscheinlich erst am Beginn einer e-Funktion - bei der im Moment noch ungewiss ist, wie steil die Kurve sein wird.

Daneben gibt es natürlich noch weitere Trends, die erst am Anfang stehen. Ich denke dabei zum Beispiel an künstliche Intelligenz oder virtuelle Realität. Die Digitalisierung und Vernetzung schreitet unaufhörlich voran. Und damit auch der Umfang der zu verarbeitenden Daten. Neue Anwendungsfelder führen zu neuen Produkten und erweiterten Funktionen. Dies beflügelt die Nachfrage nach Chips und damit nach Wafern.

Doch digitale Dienste verbrauchen viel Energie. Und Digitalisierung soll einen wichtigen Beitrag leisten, Ressourcen effizienter zu nutzen. Bei der Interaktion von Mensch und Maschine spielen Halbleiter eine bedeutende Rolle – und damit auch Wafer.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir sind davon überzeugt, dass der positive Trend für Halbleiterbauelemente und damit auch die Nachfrage nach unseren Wafern anhalten wird.

Um unsere führende Marktstellung zu halten, sind Investitionen in die Zukunft notwendig. Lassen Sie mich hierauf näher eingehen.

Wie Sie wissen, sind wir bereits seit dem dritten Quartal 2016 voll ausgelastet und können die Nachfrage unserer Kunden nach Wafern nicht vollständig zufriedenstellen. Aufgrund der erfreulichen Preisentwicklung haben wir uns entschlossen, in zusätzliche 300 mm-Kapazitäten zu investieren, um das Marktwachstum zu begleiten und unseren Marktanteil zu halten. Daher werden wir um 70.000 zusätzliche 300 mm-Wafer bis Mitte 2019 ausbauen. Diese Investition ist über vorteilhafte Langfristverträge sowie Vorauszahlungen durch Kunden gesichert. Vor kurzem haben wir einen weiteren Langfristvertrag abgeschlossen, für den wir weitere zusätzliche Kapazitäten im Jahr 2020 ausbauen werden. Nach diesen beiden Ausbaustufen stehen jedoch immer noch freie Produktionsflächen im 300 mm-Bereich für gegebenenfalls notwendige weitere Ausbauten zur Verfügung.

Da unsere theoretische Waferkapazität in den bestehenden Produktionsgebäuden derzeit höher ist als unsere Kristallkapazität haben wir uns des Weiteren dazu entschlossen, eine neue Ziehhalle am Standort Singapur zu bauen. Dies bildet die Grundlage für einen weiteren möglichen Ausbau der Waferproduktion.

Daneben investieren wir weiter in die bereits begonnenen Automatisierungsprojekte an unseren deutschen Standorten. Dazu gehören der Einsatz von sogenannten fahrerlosen Transportfahrzeugen und die Installation von automatisierten deckengebundenen Transportsystemen. Für unser Automatisierungsprojekt in Freiberg wurden wir Anfang des Jahres mit dem Innovationspreis für Automatisierung des Automation Network Dresden ausgezeichnet.

Solchen Systeme helfen uns, Kosten zu senken und die Effizienz weiter zu steigern. Aufgrund des verringerten menschlichen Kontakts minimieren wir die Gefahr von Partikeln auf den Wafern.

Die Steuerung unserer Produktion wird zunehmend automatisiert. So können wir Anlagen aufgrund ihrer aktuellen Prozessfähigkeit optimiert auslasten und damit den Ausstoß unserer Linien weiter optimieren.

Digitalisierung spielt natürlich auch bei Siltronic eine Rolle. Sie bietet für uns als Unternehmen neue Möglichkeiten, unsere Qualität, Produktivität und Prozessfähigkeit weiter und vor allem schneller zu verbessern. Denken Sie nur an neue Möglichkeiten der Bildverarbeitung oder auch das Erkennen von Abhängigkeiten in unseren Prozessabläufen durch die Analyse von Massendaten. Durch zusätzliche Sensoren und Messverfahren lässt sich der Anlagenzustand besser bestimmen und Instandhaltungsmaßnahmen nach Bedarf optimiert einsteuern. Unsere Produktivität steigern wir unter anderem durch bereits angesprochene und neue Automatisierungslösungen. Wir wollen auch den Arbeitsalltag unserer Mitarbeiter erleichtern und effizienter gestalten. Ich führe hier nur beispielhaft Monitoring Boards oder Datenbrillen an.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun auf die Finanzzahlen des vergangenen Geschäftsjahres eingehen.

Wir haben 2017 einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einer Steigerung von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung ist überwiegend auf deutliche Preissteigerungen zurückzuführen. Aber auch die abgesetzte Waferfläche hat leicht zugenommen.

Der Umsatz ist von Quartal zu Quartal gestiegen. Mit 328 Millionen Euro war das vierte Quartal 2017 das stärkste.

Wir haben die durchschnittlichen Verkaufspreise für unsere Wafer jedes Quartal sequentiell erhöhen können. Dies führte dazu, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise im vierten Quartal 2017 in US-Dollar gut 30 Prozent über denen des vierten Quartals 2016 gelegen haben. Dies gilt sowohl für unser gesamtes Produktportfolio wie auch für 300 mm.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie wissen, erzielen wir rund zwei Drittel unseres Umsatzes in US-Dollar erzielen. Daher machte sich der stärker werdende Euro gegenüber dem US-Dollar im vierten Quartal leicht bemerkbar. Der Effekt auf den Jahresdurchschnittskurs war aber vernachlässigbar.

Die regionale Verteilung unserer Umsätze ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Wir erzielten rund 67 Prozent der Umsätze in Asien, 19 Prozent in Europa und 14 Prozent in den USA.

Unsere Herstellungskosten sind aufgrund der gestiegenen Menge, der Erfolgsbeteiligung für die Mitarbeiter und Einmalaufwendungen gestiegen. Ohne Berücksichtigung dieser Einmalaufwendungen sind die Kosten pro Waferfläche weiter gesunken.

Im Ergebnis führte das dazu, dass wir unsere Bruttomarge von 18 Prozent auf 31 Prozent steigern konnten.

Das EBITDA lag 2017 bei 353 Millionen Euro und übertraf damit das Vorjahr um fast 150 Prozent. Die EBITDA-Marge erreichte 30 Prozent. Auswirkungen aus Wechselkurseffekten waren vernachlässigbar.

Auch beim EBITDA sieht man die kontinuierliche Verbesserung über die einzelnen Quartale des Geschäftsjahres 2017. Dies ist neben dem Anstieg der verkauften Waferfläche bei gleichzeitig erfreulicher Kostenentwicklung hauptsächlich auf die gestiegenen Preise zurückzuführen.

Das EBIT war mit knapp 236 Millionen Euro deutlich höher als im Vorjahr.

Das Ergebnis vor Steuern lag bei 227 Millionen Euro. Der Aufwand für Ertragssteuern in Höhe von 35 Millionen Euro ist überwiegend auf effektive Steuern in Singapur, Deutschland, den USA und den Niederlanden zurückzuführen. Die Konzernsteuerquote betrug 15 Prozent.

Das Periodenergebnis konnten wir auf 192 Millionen Euro verbessern.

Unser Eigenkapital lag im vergangenen Jahr bei 638 Millionen Euro und die Eigenkapitalquote bei 51 Prozent. Dies ist hauptsächlich auf das erfreuliche Periodenergebnis zurückzuführen.

Bei den Verbindlichkeiten sind rund 70 Millionen Euro an Vorauszahlungen von unseren Kunden enthalten. Diese beinhalten Vorauszahlungen für Investitionen in höherwertigere Produkte, aber auch Vorauszahlungen für die angekündigten Kapazitätserweiterungen 2019.

Unsere Finanzverbindlichkeiten sind auf 0 zurückgegangen, da wir ein ausstehendes Darlehen im Zusammenhang mit unserer 300 mm-Produktion in Singapur zurückgezahlt haben.

Unsere Investitionen beliefen sich 2017 auf 123 Millionen Euro. Circa 90 Millionen Euro haben wir in Capabilities, die Produktmixoptimierung, den Austausch von Kristallziehenanlagen in Freiberg und die Weiterführung der Automatisierungsprojekte an den deutschen Standorten investiert.

Wir haben bei unseren Lieferanten bereits Anlagen bestellt und Liefertermine für den Kapazitätsausbau von 70.000 Wafer sind bestätigt. Dafür haben wir letztes Jahr rund 30 Millionen Euro an Anzahlungen geleistet.

Meine sehr geehrten Damen und Herren - trotz dieser Investitionen haben wir 2017 einen Free Cashflow von 170 Millionen Euro erzielt. Hierin sind Kundenanzahlungen von circa 70 Millionen Euro enthalten.

2017 zeigte sich aufgrund der erhaltenen und gleichzeitig zurückgeführten Kundenanzahlungen im Cashflow einen Nettoeffekt von 45 Millionen. Und wir werden 2018 weitere Kundenanzahlungen in erheblichem Umfang erhalten.

Da der Zufluss und die Rückführung von Kundenanzahlungen zu zeitlichen Verschiebungen des Free Cashflows führen, beeinträchtigen sie aufgrund ihrer Höhe den Aussagegehalt dieser Kennzahl. Daher haben wir uns entschlossen, die Kennzahl Netto-Cashflow einzuführen. Diese stellt den Free Cashflow ohne die zeitlichen Verschiebungen aus Zufluss und Rückführung von Kundenanzahlungen dar.

Der Netto-Cashflow lag 2017 bei 125 Millionen Euro und war damit deutlich höher als der von 2016 mit 40 Millionen Euro.

Aufgrund des Free Cashflow von 170 Millionen Euro ist das Nettofinanzvermögen 2017 auf 342 Millionen Euro gestiegen. Damit hat es sich seit dem Börsengang mehr als verdoppelt.

Wir sehen uns hier gut aufgestellt und gehen davon aus, dass das Nettofinanzvermögen weiter zunehmen wird. Dies ist aus unserer Sicht eine gute Basis, um das künftige Marktwachstum begleiten zu können.

Meine Damen und Herren, soweit der Blick zurück. Lassen Sie uns nun den Blick nach vorne richten.

Wir wollen unser profitables Wachstum fortsetzen. Die hohe Nachfrage nach Siliziumwafern bei gleichzeitig limitierten Produktionskapazitäten hält an. Wir werden uns auch dieses Jahr auf höchstmöglichen Output konzentrieren, um die Nachfrage unserer Kunden bestmöglich zufriedenzustellen.

Wir erwarten, dass die Waferpreise weiter steigen werden, jedoch in einem langsameren Tempo als in den Vorquartalen.

Außerdem erwarten wir einen negativen Einfluss der Währungen, da der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen Yen im zweiten Halbjahr 2017 deutlich stärker wurde.

Die Fundamentalannahmen für 2018 sind positiv. Die Endanwendungen, in denen Siliziumwafer zu finden sind, werden vielfältiger. Wachstumstreiber sind der Automobilbereich sowie industrielle Anwendungen, aber auch der Endverbrauchermarkt. Es wird erwartet, dass die Halbleiterindustrie 2018 ein starkes Wachstum zeigt. Die Siliziumfläche soll um rund 5 Prozent wachsen.

Aufgrund des schwachen US-Dollars gegenüber dem Euro erwarten wir einen negativen Währungseinfluss von rund 100 Millionen Euro auf den Umsatz. Trotzdem wird der Konzernumsatz deutlich über 1,3 Milliarden Euro liegen.

Beim EBITDA rechnen wir aufgrund der US-Dollar-Entwicklung mit Gegenwind von rund 60 Millionen Euro. Trotzdem sollte die EBITDA-Marge nahe 40 Prozent liegen.

Unser Netto-Cashflow sollte deutlich höher sein als 2017.

Unsere Steuerquote wird zwischen 15 und 20 Prozent liegen und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden circa 5 Prozent vom Umsatz betragen.

Unsere Investitionen werden sich auf 240 bis 260 Millionen Euro erhöhen. Hierin sind die Basisinvestitionen, die Weiterführung der Automatisierungsprojekte, der Ausbau um 70.000 Wafer im Jahr 2019 und die neue Kristallziehhalle in Singapur enthalten.

Meine Damen und Herren, wir sind profitabel, weil wir unseren strategischen Fokus konsequent beibehalten. Wir sind ein Volumenhersteller für Siliziumwafer für die Halbleiterindustrie und richten unser Produktportfolio an den Bedürfnissen unserer Kunden aus. Wir wollen unsere führende Technologieposition halten und machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir wollen mit dem Markt wachsen. Wir arbeiten kontinuierlich an Kostensenkungen.

Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Aufsichtsrat der Siltronic AG für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.

Zentral für unser Wachstum sind unsere rund 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich tagtäglich für die Anliegen unserer Kunden engagieren. Gerade in bewegten Zeiten wie diesen ist es wichtig, auf ein hervorragendes Team bauen zu können.

Sehr geehrte Aktionäre und Aktionärinnen - ich denke, dass ich auch in Ihrem Namen unseren Dank an alle Siltronic-Beschäftigten weltweit für ihren unermüdlichen Einsatz aussprechen darf. Herzlichen Dank!

Auch unsere Mitarbeiter sollen vom Unternehmenserfolg profitieren. Daher haben wir für das Geschäftsjahr 2017 erstmals wieder eine Erfolgsbeteiligung gezahlt. Dies war in den letzten Jahren leider nicht möglich gewesen. Umso mehr freut es uns, dass die guten Geschäftszahlen dies nun ermöglichen.

Besonders stolz sind wir auf die Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus rund 30 Nationen und sehen dies als Bereicherung für Siltronic. Als globales Unternehmen sind wir in einem internationalen Markt und multikulturellen Umfeld tätig. Unsere Diversity-Beauftragte richtet neben der Frauenförderung ihr Augenmerk ebenfalls auf Vielfalt in Ausbildung, Alter und Nationalitäten.

Im Zuge der Abspaltung von Wacker setzen wir auf ein eigenes Personalmarketing. So sind wir seit Ende 2017 mit einem eigenen Auftritt auf Personalmessen vertreten und werden ab Herbst dieses Jahres eigene Auszubildende einstellen. Auf der ebenfalls neu gestalteten Homepage haben wir ein Siltronic-eigenes e-recruiting-System implementiert. Im sogenannten „war for talents“ sehen wir uns gut aufgestellt. Wir bieten viele Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens. Über unser Graduate-Programm bieten wir Hochschulabsolventen die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit Einblicke in verschiedene Abteilungen und Prozesse zu erhalten und im jeweiligen Fachbereich verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem vergangenen Jahr können wir sehr zufrieden sein. Wir haben abermals unseren Umsatz und unseren Gewinn je Aktie gesteigert. Und wir haben unsere führende Rolle in der Wafertechnologie behauptet. All das stimmt mich für das aktuelle Jahr sehr optimistisch.

Wir müssen uns für unser Wachstum ins Zeug legen – erst recht für nachhaltig profitables Wachstum. Dass wir das können, haben wir in der Vergangenheit bereits bewiesen. Und das werden wir auch künftig tun. Darauf können Sie sich verlassen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.